

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	72 家机构（共 87 人）参与公司于 2026 年 8 月 27 日举行的投资者交流会，其中包括：天风证券、华福证券、摩根基金、汇丰晋信基金、国泰海通证券、太平养老保险、申万菱信基金、华泰保兴基金、华西基金、中信建投、国海证券、中泰证券、易方达基金、光大证券、青骊投资、上海潼骁投资、深圳鑫融长弘投资、申银万国证券、上海辰翔私募、北京信弘天禾投资、新疆前海联合基金、中银理财、浙江益恒投资、宏利基金、湖南源乘私募、华金证券、美银证券、同舟商贸、平安证券、富安达基金、承珞投资、创金合信基金、上海湘楚资产、深圳前海华杉投资、北京金百镭投资、龙赢富泽资产、鹏华基金、平安基金、GIC 新加坡政府投资基金、国泰基金、交银施罗德基金、上海宽投资产、中信证券、北京阳光天泓资产、海通证券、新华基金、上海德汇集团、深圳市伯利恒资产、鑫元基金、平安养老保险、湖南长心私募、华安基金、建信理财、深圳宏鼎财富管理、前海开源基金、南方基金、东方国际资产管理、兴

	业基金、UPAMC、华宝基金、北京阳光天泓资产管理、深圳宽源私募、Willing Capital Management Limited、富国基金、兴业证券、上海隆象私募、中国人寿、华夏理财、华夏久盈资产、平安资产、开源证券、方正证券
时间	2026 年 8 月 27 日 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：邱鹏 董事会秘书兼财务负责人：廖新江
投资者关系活动主要内容介绍	首先，邱鹏先生对公司半年度情况进行了介绍，然后开始投资者交流环节。 （一）财务情况回顾：2026 年上半年，公司实现营业收入 43,661.42 万元，同比增长 37.73%；归属于上市公司股东的净利润 4,634.78 万元，同比增长 8.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,877.41 万元，同比增长 15.77%。 （二）突出业务介绍：2026 年上半年，公司半导体业务实现营业收入 17,199.34 万元，同比增长 187.58%，占公司营业收入的 39.39%，毛利率为 27.75%，同比提升 9.84 个百分点，已成为公司重要增长点。未来，公司将持续完善“深圳研发、东莞制造、苏州市场服务、新加坡国际化协同、越南本地化服务”的区域布局，进一步支撑半导体设备业务拓展与全球化发展。 （三）交流环节主要涉及的问题及回复如下： 1. 2026 年上半年公司半导体业务收入增速较快，该板块的收入结构是怎么样的？ 智立方最早从显示半导体进入半导体领域，之后逐步拓展

到光通信、IC 封测领域。2025 年半导体业务中显示收入占比
较高，2026 年上半年 IC 封测和光通信相关收入逐渐增加，带
动板块毛利率提升，增长主要来源于行业景气度的提升、产品
和客户的持续拓展。

2. 今年以来光通信行业景气度较高，公司是否明显感受到客户扩产带来的设备需求增长？

回复：从目前客户交流及项目推进情况看，行业扩产较为
积极，增量需求主要来自三个方面：一是客户扩产带动排 Bar、
拆 Bar、Bar AOI、Chip AOI 等成熟设备需求；二是高速光模块
及 NPO、CPO 等技术演进，带来光芯片测试、高精度 Bonding
等设备机会；三是产能提升推动部分人工或半自动工序向全自
动化升级。总体而言，这一轮行业需求增长，不仅会带动客户
增加设备投入，也会带来技术升级和自动化改造的新需求。

**3. 这一轮光通信行业需求比较旺盛，从客户扩产到最终
体现在公司收入端，一般需要多长时间？**

回复：设备项目从需求到收入端的周期不固定，通常 10 个
月到 1 年半不等。一般需要经过需求确认、方案设计、下单、
生产交付、安装调试和客户验收等环节；新产品还可能增加样
机测试、工艺适配和验证导入过程。项目周期受设备标准化程
度、客户现场条件、验证要求及验收安排等多种因素影响，差
异较大。

公司内部更关注的还是客户实际扩产方向、项目推进情况
以及新产品验证进展。相关需求何时形成收入贡献，仍取决于
具体项目的下单、交付及验收节奏。

**4. 目前光通信设备的新增订单主要来自老客户扩产，还
是新产品、新客户导入？**

回复：目前两方面均有。一方面，原有客户扩产及设备更新带动排 Bar、拆 Bar、AOI 等成熟设备需求，并进一步增加 Chip Testing、高精度 Bonding 等设备机会；另一方面，公司持续拓展新产品和新客户，扩大国内客户产品覆盖，并推进海外客户验证和市场开拓。整体来看，新增需求由老客户扩产、新客户导入和产品品类拓展共同推动，具体进展仍取决于项目验证、下单、交付及验收情况。

5. 请介绍 Flip Chip 应用及客户导入进展。

回复：公司已布局 Flip Chip 设备，相关产品目前主要处于客户验证和导入阶段。该设备对精密定位、机器视觉、运动控制和贴装精度要求较高。公司具备相应的底层技术积累。

公司正结合客户实际项目推进应用验证，以及根据客户工艺需求持续优化产品。

6. 请介绍公司在 Hybrid Bonding 领域的布局及研发进展。

回复：Hybrid Bonding 是公司持续关注 and 开展技术储备的方向。随着先进封装向高密度、高性能发展，互联密度和封装精度要求不断提升。公司在推进 Die Attach、Flip Chip 产品的同时，也开展 TCB、Hybrid Bonding 相关研发。上述设备在精密定位、键合、视觉及控制等底层技术上具有共通性，现有产品开发和客户应用将为后续技术积累提供支撑。

7. 与海外先进封装设备厂商相比，公司在精度、效率、工艺能力和客户验证方面分别处于什么阶段？

回复：海外领先厂商经过长期积累，在设备效率、长期稳定性、工艺经验及规模化客户验证方面整体更为成熟。公司依托高精度运动控制、机器视觉和自动化设备能力，已具备相关

底层技术基础，但不同产品仍处于研发、工艺适配或客户验证阶段，部分能力需要持续积累。随着 Flip Chip、TCB、Hybrid Bonding 等应用需求增长，公司将通过产品迭代和客户验证逐步提升竞争力。

8. 公司和施耐博格目前主要有哪些合作？这块业务现在进展怎么样？

回复：公司和施耐博格在高精度运动平台方面有持续合作。

施耐博格在精密运动和高精度定位方面有比较长期的技术积累，公司在设备应用、自动化、机器视觉以及国内客户服务方面也有自己的经验。

目前双方围绕相关产品持续推进开发和应用。从下游来看，现在主要还是面向半导体检测、量测以及其他高精度设备。公司目前正在跟一些国内半导体设备客户进行产品验证和合作，处于逐步导入阶段。

9. 公司传统消费电子业务今年怎么样？怎么看后续发展？

回复：公司消费电子业务整体保持平稳，公司持续围绕核心客户的新产品、新工艺需求开展设备开发和交付。未来，随着 AI 技术向手机、PC、智能穿戴、机器人等终端硬件渗透，产品形态、功能及制造工艺的变化有望带来新的自动化设备需求。公司将继续紧跟客户需求，推进相关设备开发。

10. 结合目前订单和项目交付节奏，公司如何看待下半年及明年的经营趋势？

回复：结合目前订单及项目推进情况，消费电子业务主要跟随客户新产品发布和资本开支节奏推进，半导体设备则处于产品持续导入、客户不断拓展的阶段。

光通信行业需求活跃，客户扩产方向明确，公司也在积极推进相关订单的生产和交付。

先进封装方面，裸芯片分选、Die Attach 和 Flip Chip 等产品正在推进客户验证和导入，TCB、Hybrid Bonding 等产品仍处于研发和技术储备阶段。随着相关产品逐步完成验证以及新产品的开发，预计半导体设备的客户覆盖和应用场景会持续增加。

由于设备从需求确认、下单到交付验收需要一定周期，行业需求、设备订单与报表收入之间可能存在时间差，具体经营表现取决于项目交付及验收进度。

11. 请公司介绍一下光模块自动化设备的在手订单、客户情况、后续新品进展开发，面向 CPO 和 NPO 进展如何？

回复：光通信客户芯片端、器件端、模块端的需求旺盛，目前公司产品覆盖国内绝大部分光通信领域客户，海外客户正在取得进展，在手订单和项目充足。NPO/CPO 的方向，公司依托优质的客户资源积极储备和布局新的产品。

12. 光芯片自动化设备的扩产速度如何，当前产能能够支撑多少收入？

回复：目前公司光芯片段成熟的设备（排 bar、拆 bar、bar AOI、chip AOI 等）基本实现了供应链的本地化，交付周期有充分保障，同时公司也在持续扩充人员场地以更好地满足客户需求。

13. 公司在光芯片的排 bar、拆 bar 设备的技术壁垒在哪里？

回复：这两款设备公司开发比较早，并且研发周期也比较长。设备的难点主要体现在视觉对准、高速高精密取放、设备

	振动抑制等方面。公司产品经历长时间的打磨，目前客户端反馈非常好，并由此和客户建立了较强黏性。 14. NPO 包括后续 1.6T、3.2T 设备的升级，公司主要提供的光通信设备会有怎样的升级和变化？ 回复：NPO/CPO 变化主要是产品形态的变化，光芯片本身的工艺不会发生大的变化，依然需要用到公司的排 bar、拆 bar、bar AOI、chip AOI 包括后续推出的测试设备等。同时，技术和产品的升级会带来精度和自动化程度的提升，公司也会配套做对应的产品升级。 15. 公司目前是否布局硅光晶圆测试设备？ 回复：目前公司已关注到客户在硅光晶圆测试及 AOI 检测方面的需求，相关设备与公司现有技术能力具有一定协同性。公司正在结合客户需求、技术方案及市场空间，对相关项目的可行性进行评估。 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 28 日